



2026年5月5日～7日に開催されます

「SEMICON Southeast Asia (SEMICON SEA) 2026」に出展いたします。皆様のご来場お待ちしております。

#### 【出展内容】

##### (新機種 パネルレベルパッケージ対応 PLP-700)

サイズが最大 700 mm×700 mmに対応するパネルレベルパッケージ用の最新設備(PLP-700)のパネル展示を中心に、半導体設備の提案を致します。

\* PLP-700 詳細情報は SEMICON SEA 2026 会場にて

##### (会場)

- ・ Toyo Adtec Co., Ltd  
ホール 5-8, LEVEL2, SINGAPORE PAVILION BOOTH NO. 2427
- ・ Millice Sdn Bhd  
ホール 1-4, LEVEL1, MALAYSIA PAVILION BOOTH NO. 1558

##### (新機種 12 インチ用マルチワイヤーソー MWS-SiC12F)

大口径インゴット (Φ 12 インチ対応※最大 14 インチまで) 切断用の最新型マルチワイヤーソーMWS-SiC12F をパネル展示致します。

\* MWS-SiC12F 詳細情報は SEMICON SEA 2026 会場にて

##### (会場)

- ・ Millice Sdn Bhd  
ホール 1-4, LEVEL1, MALAYSIA PAVILION BOOTH NO. 1558

(SEMICON SEA 2026 公式サイト)

[SEMICON Southeast Asia 2026](#)

